

## 자람테크놀로지, 코스닥 상장 위한 증권신고서 제출

▶ 공모구조 조정 거쳐 코스닥 상장 절차에 재시동

▶ 상장주관사 신영증권, 2월 15일~16일 수요예측...2월 22일~23일 청약 진행 예정

**<2023-01-19> 차세대 통신반도체 설계기업 자람테크놀로지(대표이사 백준현)가 금융위원회에 증권신고서를 제출하며 IPO를 재개했다고 19일 밝혔다.**

자람테크놀로지(이하 회사)는 글로벌 인플레이션 우려, 금리 인상에 따른 자금 경색 등 주식시장의 외적 변수에 의한 부진과 변동성 확대 우려가 심화되던 지난 12월 초 기관 투자자 수요예측을 실시한 후 상장 절차를 잠정 중단한 바 있다.

이후 회사는 공모구조, 고객사 추가 수주 현황, 시장 상황 등을 다방면으로 고려해 공모 재도전을 결정했다. 조정 공모주식수는 930,000주, 공모 예정가는 16,000원(공모 희망 밴드가 하단 기준)으로 낮췄다. 또한 기존 주주들의 보유물량 대부분에 자율적 락업을 걸어 상장 후 오버행 위험을 대폭 줄였으며, 상장 후 유통가능비율은 14.14%에 불과하다.

주관사인 신영증권 관계자는 "자람테크놀로지 상장 재추진은 시장의 의견을 수렴하여 공모 구조 조정으로 투자자 친화력을 높이려 노력했다"고 말했다. 또한 자람테크놀로지 관계자는 "회사의 차세대 통신반도체 설계기술은 고성능 시스템 반도체 설계에 적용 가능할 정도로 수준이 높아 추후 성장 파이프라인의 확장도 기대할 수 있다"고 소회를 밝혔다.

회사는 AP칩, 멀티미디어 신호처리 전용반도체, 하이패스 단말기용 반도체 등 다양한 반도체의 개발과정에서 축적한 기술력과 노하우를 보유하고 있다. ▲광트랜시버 ▲기가와이어 ▲DVT 등을 안정적 캐시카우 제품으로 보유하고 있으며 ▲XGSPON SoC ▲XGSPON 반도체칩을 결합한 스틱 형태의 제품인 XGSPON STICK 등의 차세대 제품을 확보하고 있다.

정보통신기술(ICT)에 기반한 4차산업 융합서비스가 일상화됨에 따라 회사는 글로벌 전반에서 차세대 통신반도체에 대한 높은 수요가 있을 것으로 보고 선제적인 연구개발을 진행했다. 그 결과 회사는 초고속 통신망 구축에 필수적인 차세대 통신반도체 XGSPON SoC를 국내 최초로 개발 및 상용화했다. 또한 회사가 개발한 광부품일체형 XGSPON STICK은 일본 라쿠텐사(社) 5G망에 적용되어 세계 최초 상용화도 성공했다.

한편, 자람테크놀로지의 총 공모 주식수는 930,000주이며, 상장예정 주식수는 6,197,730주다. 공모 구조는 구주 매출 없이 신주모집 100%로 진행 예정이며, 공모 희망 밴드가는 16,000원~20,000원으로 공모 후 예상 시가총액은 99,164백만 원~123,955백만 원이다. 기관투자자 대상 수요예측



은 2월 15~16일, 일반투자자 대상 청약은 2월 22~23일 진행 예정이다. 상장 주관사는 신영증권이다.

구 분	2022년 11월 증권신고서 내 용	2023년 1월 증권신고서 내 용
공모주식수	1,000,000 주 (신주 900,000 주, 구주 100,000 주)	930,000 주 (신주 930,000 주)
공모예정가	18,000 원~22,000 원	16,000 원~20,000 원
총 공모예정금액	18,000 백만원~22,000 백만원	14,880 백만원~18,600 백만원
예상 시가총액	111,057 백만원~135,736 백만원	99,164 백만원~123,955 백만원
상장예정주식수	6,169,830 주	6,197,730

-끝-